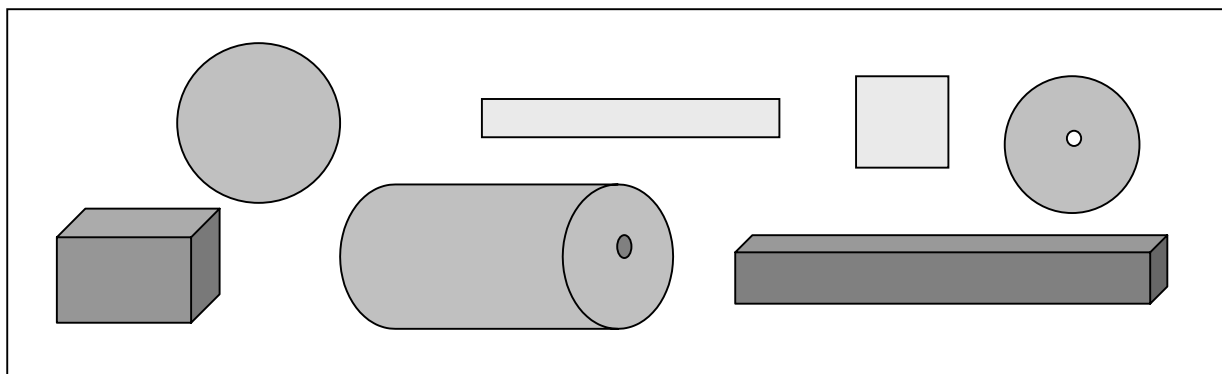


# Установочная керамика



Основная кристаллическая фаза - форстерит, муллит, цельзиан, периклаз, корунд.

## *Основные характеристики:*

- диэлектрическая проницаемость:  $\epsilon = 5,5...10,5$
- электрическая прочность: **не менее 25 МВ/м.**
- тангенс угла диэлектрических потерь:  $\text{tg}\delta = 2 \times 10^{-4}$  ( $f = 1$  МГц)
- механическая прочность: **78...147 МПа**
- коэффициент термического линейного расширения:  $\alpha_{20...100} = 2...12 \text{ MK}^{-1}$
- микропористость: **2...5 %**
- размер пор: **до 5 мкм**
- температура спекания в воздушной среде:  $T_{\text{спек}} = 1250...1700 \text{ }^\circ\text{C}$

Установочная керамика предназначена для изготовления плат микромодулей, подложек для микросхем, непроволочных резисторов, высоковольтных и подстроечных конденсаторов, изоляторов и других установочных деталей.